
证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股



**鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告**

二〇二二年十二月

公司为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，拟非公开发行股票募集资金用于庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目、宏恒胜汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目以及补充流动资金。公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中含义相同）：

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目	420,000.00	220,000.00
2	宏恒胜汽车板及服务器板项目	112,000.00	80,000.00
3	数字化转型升级项目	80,000.00	50,000.00
4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		662,000.00	400,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

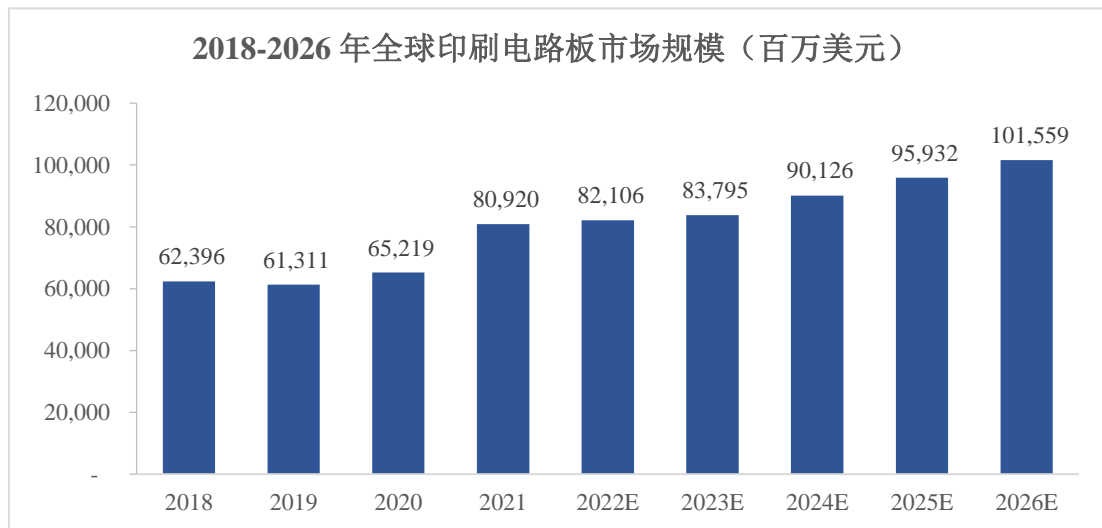
二、本次募集资金投资项目的实施背景

（一）下游应用领域蓬勃发展，全球 PCB 产值不断增长

PCB 是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、服务器、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子器件，印制电路板产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

随着下游通信、汽车、云计算、物联网、智能家居、可穿戴设备等新兴领域

的蓬勃发展，作为整个电子产业链中承上启下的基础力量，PCB 行业迎来了新一轮的发展周期。Prismark 数据显示，在手机、个人电脑、汽车电子等领域带动下，2021 年全球 PCB 市场实现大幅增长，市场规模达 809.20 亿美元，同比 2020 年增长达 24.1%。同时，Prismark 预测 2021 至 2026 年之间全球 PCB 行业产值将以 4.6% 的年复合增长率成长，到 2026 年将达到 1,015.59 亿美元。



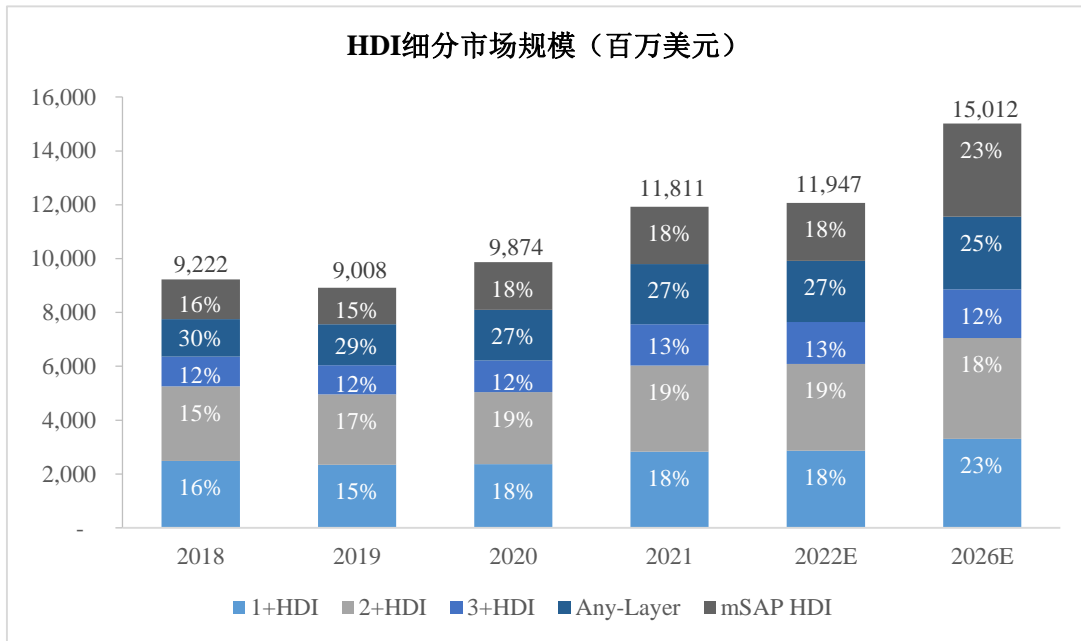
数据来源：Prismark，2022 年 8 月

（二）下游电子产品小型化趋势推动 SLP 渗透率提升

智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以及多功能化方向发展的同时，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其对印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在这样的背景下，PCB 的线宽、线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。HDI 能够实现更小的孔径、更细的线宽，节约 PCB 可布线面积、大幅度提高元器件密度、改善射频干扰/电磁波干扰/静电释放等，可以在满足终端电子产品性能及效率标准的前提下，实现更加小型化、轻薄化的设计。随着电子产品的持续更新换代，HDI 板市场规模不断增长，根据 Prismark 数据，HDI 板 2021 年市场规模为 118.11 亿美元，预计 2026 年可达 150.12 亿美元。

伴随着 5G 跨 6G 的到来，下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求，对于 PCB 也延伸出新的技术迭代需求。SLP（在 HDI 技术基础上，采用 mSAP 等工艺的新一代精细线路印制板）相较于传统 HDI，进一步细化线路，线宽线距更小，堆叠层数更多，可以承载更多的功能模组，且图形精细化程度及可

可靠性均可满足高端产品的需求，是印制电路板行业生产制造技术在性能上向高密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄型方向的进一步发展。根据 PrismaMark 数据，mSAP HDI 板 2021 年市场规模为 21.26 亿美元，占全球 HDI 市场的 18%，预计 2026 年可达 34.52 亿美元，占全球 HDI 市场的 23%，复合增长率可达 10.2%。



数据来源：PrismaMark，2022 年 8 月

（三）汽车智能化转型带动汽车 PCB 市场扩大

随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向电动化、轻量化、智能化、网联化方向发展，从交通工具转变为大型移动智能终端。随着 ADAS 乘用车逐渐落地，智能驾驶在逐步增加 L3 功能，直至推出 L4/5 车型。根据 IHS 数据，2025 年全球智能驾驶车辆将超过三百万辆，智能驾驶市场规模达到 26 亿美元，到 2030 年全球 L4 级别的自动驾驶车辆渗透率将达到 15%。电子硬件能力是信息技术与汽车产品融合的基础。随着智能驾驶向高阶演进，市场不断向中低端车型传导和渗透，带来感知、传输、算力、控制等电子硬件能力的整体提升。消费者对汽车安全性、环保性、舒适性、智能化等方面的需求持续提升，有效促进汽车电子领域上游各类电子器件及组件行业的快速发展。

随着全球汽车产业从电子化进入智能化、电动化时代，汽车行业电子产品产值得持续向上攀升。根据 Statista 预测，到 2030 年汽车电子占整车直接成本将达到

45%。据 Prismark 预测，汽车行业电子产品产值在 2021 至 2026 年之间将以 7.0% 的年复合增长率成长，2026 年产值将达 3,370 亿美元。

ADAS、传感器等汽车电子应用快速发展的智能化浪潮下，汽车 PCB 作为各类汽车电子应用的重要底座支撑，将随着汽车电子市场的发展保持增长趋势。根据 Prismark 数据，2021 年全球汽车领域 PCB 市场规模为 87.28 亿美元，占全球 PCB 市场的 10.8%，预计 2026 年全球汽车领域 PCB 市场规模将达到 127.72 亿美元，2021 年-2026 年复合增长率为 7.9%。

（四）数字经济带动算力需求，服务器 PCB 市场规模迅速扩容

近年来，数字经济已成为全球经济发展的主要驱动力，数字经济规模占 GDP 比例稳步提升。根据中国信息通信研究院数据，2021 年，全球数字经济 GDP 占比已达到 46%，我国数字经济 GDP 占比达到 40%，预计 2025 年，我国数字经济 GDP 占比将达到 62%。数字经济产业的发展带来全球数据流量的迅速增长。根据 Cisco Global Index 数据显示，2016 年全球数据中心流量规模为 6.8ZB，到 2021 年规模增长至 20.6ZB，复合增长率为 25%；根据 IDC 数据，预计 2025 年全球数据量达 175ZB。

随着全球数据流量的指数级增长以及全球信息化建设速度加快，服务器作为最重要的算力基础设施，全球范围内的出货量与市场规模得以大幅增长。根据 Gartner 数据，2021 年全球服务器总体市场规模达到 6,634 亿元，预计 2026 年达到 10,600 亿元，复合增长率达 9.83%。

PCB 是服务器的重要组成部分，是承载服务器运行的关键材料。服务器出货量的大幅增长也使得服务器 PCB 市场规模迅速扩容，成为 PCB 市场中复合增长率最快的下游细分市场。根据 Prismark 数据，2021 年全球服务器领域 PCB 市场规模为 78.04 亿美元，预计 2026 年达到 132.94 亿美元，复合增长率为 11.2%。

全球 PCB 按下游应用分类的市场规模情况具体如下：

全球 PCB 按下游应用分类市场规模（百万美元）					
	2020	2021	2022E	2026E	2021-2026 复合增长率
服务器	5,876	7,804	9,292	13,294	11.2%

全球 PCB 按下游应用分类市场规模（百万美元）					
	2020	2021	2022E	2026E	2021-2026 复合增长率
汽车	6,507	8,728	9,350	12,772	7.9%
移动电话	13,950	16,116	16,284	21,214	5.7%
无线基础设施	2,771	3,337	3,551	4,331	5.4%
有线基础设施	4,968	6,111	6,704	7,901	5.3%
工业	2,563	3,226	3,463	3,832	3.5%
军事/航空航天	2,824	3,113	3,227	3,596	2.9%
消费	9,466	11,858	11,562	13,636	2.8%
医疗	1,273	1,532	1,584	1,743	2.6%
其他电脑设备	3,801	4,554	3,724	4,939	1.6%
个人电脑	11,220	14,542	13,368	14,301	-0.3%
合计	65,218	80,920	82,106	101,559	4.6%

数据来源：Prismark，2022 年 8 月

（五）数字化转型是实现我国从工业大国迈向工业强国、制造强国的重要一环

从 2015 年 5 月，国务院正式印发《中国制造 2025》，提出推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；到 2021 年 12 月，工信部、国家发改委等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出以新一代信息技术与先进制造技术深度融合为主线，要求深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、发展数字经济、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。

伴随着新一代信息技术的快速发展与先进制造技术的深度融合，全球掀起了以智能制造为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主要趋势，智能制造在全球范围内对产业发展和分工格局带来深刻影响，并推动形成新的生产方式、产业形态、商业模式。工业数字化转型是抓住新一轮科技革命和产业变革，实现我国从工业大国迈向工业强国、制造强国的重要一环。推进制造业数字化转型，对于贯彻落实供给侧结构性改革，培育经济增长

新动能，推动制造业向中高端迈进具有重要意义。近年来，在国家大力支持以及数字技术快速发展的背景下，国内工业企业数字化已取得了积极的进展。

（六）产业政策大力支持 PCB 产业发展

PCB 是电子信息产业的基础产品，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。近年来，我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策，以推进 PCB 行业的战略调整与产业升级，为国内 PCB 企业提供了良好发展契机。相关产业政策如下：

时间	部门	政策名称	有关内容
2022 年 10 月	国家发 改委、 商务部	《鼓励外商投资产 业目录（2022 年 版）	明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠 性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线 路（线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$ ）柔性电路板等”列入鼓 励外商投资产业目录。
2022 年 10 月	中共中 央	《二十大报告》	坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新 型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强 国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基 础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特 新发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发 展。
2021 年 12 月	国务院	《“十四五”数字 经济发展规划》	提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心 电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水 平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链 补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和 产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、 集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等 重点产业供应链体系。
2021 年 9 月	工信部	《中国电子元器件 行业“十四五”发 展规划 （2021-2025）》	产业规模不断壮大。进一步巩固电子元器件生产地 位，充分满足信息技术市场规模需求。提升产业创 新能力；强化市场应用推广：瞄准智能手机、穿戴 式设备、无人机、VR/AR 设备、环境监测设备等智 能终端市场，推动微型片式阻容元件、微型大电流 电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、 高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高 性能的电子元器件应用。
2021 年 3 月	国务院	《中华人民共和国 国民经济和社会发 展第十四个五年规 划和 2035 年远景 目标纲要》	打造数字经济新优势：提升通信设备、核心电子元 器件、关键软件等产业水平。

时间	部门	政策名称	有关内容
2021年1月	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	提出到2023年电子元器件销售总额达到2.1万亿元，突破一批电子元器件关键技术，重点发展产品包括高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板等。
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料列为鼓励性产业目录。
2019年1月	工信部	《印制电路板行业规范条件》《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》	加强印制电路板行业管理，提高行业发展水平，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。
2015年5月	国务院	《中国制造2025》	提出“强化工业基础能力，解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。”

三、本次募集资金投资项目情况

（一）项目情况

1、庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目

（1）项目基本情况

庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目由公司全资子公司庆鼎精密电子(淮安)有限公司实施，实施地点为淮安经济技术开发区，建设期五年。通过本项目的实施，公司能够逐步实现 10 层及以上高阶甚至 Any-layer HDI 产品的量产，以及基于 mSAP 工艺的最小线宽/线距 20/20 μ m 的 SLP 产品的量产。项目建成后，公司能够新增高阶 HDI 及 SLP 年产能 500 万平方英尺以上。

（2）项目投资概算

本项目计划总投资 420,000.00 万元，主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费等。本项目拟使用募集资金投入 220,000.00 万元。

（3）项目经济效益评价

本项目具备较好的经济效益。

（4）项目审批及备案情况

截至本报告公告日，本项目正在办理相关备案和审批手续。

2、宏恒胜汽车板及服务器板项目

（1）项目基本情况

宏恒胜汽车板及服务器板项目由公司全资子公司宏恒胜电子科技（淮安）有限公司实施，实施地点为淮安经济技术开发区，建设期两年。本项目在现有开发技术及生产工艺的基础上，在淮安宏恒胜厂区内改造建设新一代车载网通生产基地，实现主要面向 ADAS 的高阶多层汽车 HDI 产品以及高板层、高板厚及高速材料的服务器板产品的量产。通过本项目的实施，公司能够新增汽车 HDI 板年产能 120.00 万平方英尺以上，新增服务器板年产能 180.00 万平方英尺以上。

（2）项目投资概算

本项目计划总投资 112,000.00 万元，主要投资包括建筑工程费、生产设备购置费等。本项目拟使用募集资金投入 80,000.00 万元。

（3）项目经济效益评价

本项目具备较好的经济效益。

（4）项目审批及备案情况

截至本报告公告日，本项目正在办理相关备案和审批手续。

3、数字化转型升级项目

（1）项目基本情况

数字化转型升级项目由鹏鼎控股（深圳）股份有限公司实施，实施地点为深圳市宝安区，建设期三年。本项目基于公司已有数字化和智能化基础，围绕数字化管理和智能化制造进行升级，按照数字转型和智慧工厂两大类购置硬件设备、软件授权、设计咨询服务等。

通过数字化转型升级项目的实施，公司将不仅仅实现工厂生产的自动化，还将实现整个公司的数字化转型，通过运用工业 4.0 技术，透过各种不同应用场景，

使企业运营管理系统更有效力（资讯透明化、作业协同化、管理效率化、决策精准化、制造/服务智慧化），建立可持续发展的竞争优势。

（2）项目投资概算

本项目计划总投资 80,000.00 万元，主要投资包括机房改造工程费、设备购置费、软件购置费等。本项目拟使用募集资金投入 50,000.00 万元。

（3）项目经济效益评价

本项目不产生直接的经济效益，但是能够提升生产、管理水平，进一步提升公司的运营效率，符合公司发展战略需要。

（4）项目审批及备案情况

截至本报告公告日，本项目的立项备案正在办理中。数字化转型升级项目属于环境友好型项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，本项目不需要履行环境影响评价的审批程序。

4、补充流动资金

公司拟将本次非公开发行募集资金中的 50,000.00 万元用于补充流动资金以满足公司业务对流动资金的需求，优化资本结构、提升偿债能力，从而提高公司的抗风险能力和整体盈利能力。

（二）项目实施的必要性

1、抓住市场机遇，扩大重点行业产品布局

公司产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游产品。

在通讯及消费电子领域，2020 年以来，随着 TWS 耳机、智能手表、智能手环的普及，全球可穿戴市场稳步发展；而在元宇宙的大浪潮下，作为构建元宇宙的重要载体，VR/AR 产业也将迎来快速发展期。跟据 Prisma 数据，2021 年全球消费电子领域产值为 3,650 亿美元，并将在 2026 年达到 4,230 亿美元。

在汽车电子领域，随着汽车产品加快向电动化、轻量化、智能化、网联化方

向发展，汽车行业电子产品产值持续向上攀升，也带来汽车 PCB 市场的不断增长。在服务器领域，受益于数字经济发展带来的全球范围内服务器出货量的大幅增长，服务器 PCB 市场规模也得以迅速扩容。根据 Prismark 数据，全球汽车 PCB 及服务器 PCB 在 2021-2026 复合增长率分别为 7.9% 及 11.2%，将成为 PCB 市场中复合增长率最快的两个下游细分市场。

庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目以及宏恒胜汽车板及服务器板项目所生产产品主要面向通讯及消费电子、汽车电子及服务器等下游领域。面对良好的市场机遇，公司有必要通过募投项目的实施来扩大相关重点行业的布局，进一步强化公司的市场竞争力。

2、引领行业技术发展趋势，为市场提供设计更复杂、更高端的 PCB 产品

近年来，随着下游行业电子产品持续更新换代，高性能电子产品对 PCB 提出了更高的要求，不断带动 PCB 行业技术迭代升级加速，新工艺、新技术、新产品不断涌现。

在通讯及消费电子领域，随着智能手机、平板电脑和可穿戴设备等不断向智能化、小型化、多功能化等趋势发展，其功能不断增多，I/O 数也随之越来越多。对于平板电脑、笔记本电脑等内部空间相对较大的消费电子产品，HDI 不断向更多层更高阶的方向发展以满足愈来愈多的功能要求。但 HDI 堆叠层数的增加会带来板厚的增加，难以满足手机、可穿戴设备等电子产品对小型化、轻薄化的要求，采取 mSAP 工艺、线宽线距更小、能实现用更薄的板承载更多功能模组的 SLP 产品成为解决这一问题的必然选择。从 2017 年苹果导入 SLP 产品开始，随着高端电子产品功能的不断演进，对 SLP 的设计要求亦不断提高，线宽线距不断缩小，现今的线宽/间距要求已降至 30/30 μm ，预计会进一步降至 25/25 μm ，甚至 20/20 μm 。

在汽车电子领域，随着智能驾驶向高阶发展，对感知、传输、算力等硬件能力提出更高的要求。汽车环境要求 ADAS 域控制器和毫米波雷达在各种电磁和高低温环境下，都能够保持稳定可靠的工作。毫米波雷达普遍使用高频 PCB，要求 PCB 天线具有低损耗，并且具有良好的介电常数容差变化；ADAS 域控制器要进行高速运算，要求 PCB 必须保证良好的信号传输。在材料升级的同时，

随着智能驾驶的演进，面向 ADAS 的 PCB 产品同样朝着高阶多层厚板的方向发展，下游设计要求从现有的通孔、一阶板朝着三阶、四阶的 2 毫米以上板厚 HDI 产品演进。

在服务器领域，随着服务器设备向高速、高带宽、高密度方向发展，服务器平台对传输速率的要求越来越高，对服务器 PCB 层数的要求也在逐渐增加。PCB 层数越多，设计越灵活，能够对电路起到更好地抗阻作用，更易于实现芯片之间地高速传输。目前普遍使用的 PCIe 4.0 接口的传输速率为 16Gbps，服务器 PCB 层数为 12-16 层。随着服务器平台升级到 PCIe 5.0，传输速率达到 36Gbps，PCB 的层数将达到 18 层以上，层数的提高也会带来板厚的升级，从 12 层板的 2 毫米逐渐升级到 3 毫米以上。此外，信号频率越高，PCB 传输损耗越大，服务器 PCB 产品的材料亦会从低损耗材料升级为超低损耗材料。

公司作为全球 PCB 行业龙头，积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，持续走在行业技术前沿。因此，公司有必要引领行业技术发展趋势，通过庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目以及宏恒胜汽车板及服务器板项目的实施，建设生产基地、产线，购置先进生产设备，及时响应市场需求，实现满足市场高端电子产品需求的高端 PCB 产品的量产。

3、进一步扩大产能，巩固公司行业龙头地位

随着电子产业的迭代加速，PCB 行业产值稳步增长，具有广阔的市场空间和良好的发展前景。公司是全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商。凭借具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力以及完善的品质保障能力，公司连续多年位列中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜中国第一以及连续五年（2017 年-2021 年）位列 PrismaMark 以营收计算的全球最大 PCB 生产企业。在快速发展的同时，公司亦成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，与下游领先品牌客户建立了紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系，合作力度逐步提升。但受限于场地、设备、人员等生产要素，部分产品的现有产能已无法满足快速增长的客户需求。

因此，公司亟须通过庆鼎精密高阶 HDI 及 SLP 扩产项目以及宏恒胜汽车板及服务器板项目的实施进一步扩大产能，满足下游客户需求，提升市场份额，进而巩固公司全球行业龙头的地位。

4、顺应国家智能制造发展趋势，紧跟数字化行业前沿，降本增效，实现智能化决策

智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎中国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。在国家已经出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《国家智能制造标准体系建设指南（2021 版）》《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021 版）》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》中，提出鼓励企业深入实施智能制造工程，将新一代信息技术与先进制造技术深度融合，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，促进制造业高质量发展。

作为为全球领先科技品牌客户提供一站式 PCB 服务的 PCB 龙头企业，公司需要具有与外在和内在需求相匹配的数字化水平。公司自成立以来，持续与全球领先的电子品牌客户合作。电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”，要求 PCB 生产商具有高效的信息化管理系统，确保为客户提供优质、及时、稳定的产品及服务。同时，PCB 产品工艺步骤多、工艺复杂，需要对不同层数、不同工艺难度的产品采用精细化管理。多样的产品线带来生产过程的随机性和复杂性逐步加剧，不仅生产制造本身的计划、实施、控制和管理要求越来越高，而且还需要更加高效地组织要素之间、区域之间的产业协作。

因此，公司需要通过数字化转型升级项目的实施，提高数字化、智能化水平，顺应国家智能制造发展趋势，紧跟数字化行业前沿，建立与客户要求相匹配的先进生产组织和管理模式，满足公司自身降本增效、提高决策准确度的刚性需求。

5、优化资本结构，提升经营稳健性

近年来，随着生产研发和市场开发的持续投入，公司资产规模和业务规模不断增加，资金需求亦进一步提高。因此，为了满足公司发展需要，公司将部分本次非公开发行股票中的募集资金用于补充流动资金，增强公司资金实力，满足未来公司业务规模持续增长的运营资金需求，改善公司的资本结构，提高公司抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续发展。

（三）项目实施的可行性

1、产业政策大力支持

PCB 是电子信息产业的基础产品，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。近年来，我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策，鼓励和推进 PCB 行业的发展，具体政策详见本报告“二、本次募集资金投资项目的实施背景”。产业政策的大力支持为本次募投项目实施提供了有力保障。

2、下游行业市场发展空间广阔

本次募投项目主要涉及的下流领域为通讯及消费电子、汽车电子及服务器领域，本次募投项目产品所涉及的应用领域市场快速增长，前景良好，详见本报告“二、本次募集资金投资项目的实施背景”。广阔的市场需求为本次募投项目实施提供了盈利预期。

3、公司人员、技术、客户储备充足

公司已在印制电路板研发、生产、管理及销售的各个环节培养和积累了大批优秀人才，组建了一支具备高分子材料、化学化工、电子电力、机械工程等多学科复合背景的专业研发团队，培养了一支具备深厚的电子产业背景与多年相关实务运作经验的成熟经营团队，截至 2022 年 9 月末，公司在全球范围内拥有 39,917 名员工，能够为本次募投项目的实施提供充足的人才资源。

公司长期专注并深化 PCB 技术研发，是全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商。公司在 5G 跨 6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局，并在新一代

电子信息产业领域中，不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向；同时，公司建立了较为完善的研发体系，建立技术研发中心，架构了产、学、研合作的前瞻技术研发计划开发平台，持续推进产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用，通过与世界一流客户的合作研发提前布局未来三年可能出现的产业与技术，及时把握 PCB 前沿技术的发展方向；公司已经成为具有丰富的行业经验和技術积累的行業领先企业，截至 2022 年 9 月末，公司累计获得专利 1,053 项，其中 91% 为发明专利，能够为本次募投项目的实施提供有力的技术支持。

公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系，具备为下游客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡、大量生产的服务能力，与下游领先品牌客户建立了紧密联系，形成长久且稳固的商业合作伙伴关系。公司自成立以来，长期服务于全球领先的电子品牌客户，与国内外知名的品牌客户、EMS 厂商以及模组厂商均建立了良好的业务合作关系，并顺利切入国内外汽车电子领域 Tier1 客户，为本次募投项目的实施提供了可靠的客户储备。

4、良好的数字化基础

过去几年，公司持续推动工业 4.0 的进程，不断推进智能生产和智能工厂的建设，新建生产线均已具备了一定的智能化生产水平，同时不断对旧生产线进行智能化改造。此外，公司 2020 年已上线 SAP 系统并持续优化，各大业务领域已拥有较为完善的信息化系统，且运行稳定。公司 2021 年参加工信部智能制造能力成熟度模型（GB/T 39116-2020）评估，成为目前全国少数达到 4 级优化级水平的企业之一。

因此，公司已具备良好的数字化、智能化基础，数字化能力能够实现快速响应市场需求，数字化转型升级项目系基于现有基础进行的进一步升级、优化和改造，以提升管理效率及决策准确率，实现精准预测市场变化，并逐步实现生态协同的长期目标，具备可行性。

5、使用部分募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定

本次非公开发行股票部分募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法规中关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目顺应下游应用领域发展趋势，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行将进一步扩大公司产能，加强公司在通讯及消费电子、汽车电子以及服务器等行业的布局，巩固公司在 PCB 行业的龙头地位，提升公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产规模将有所增长。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，公司的资金实力将显著增强，核心竞争力将全面提高，有利于增强公司未来的持续盈利能力。

五、可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划政策和产业发展的需求，契合公司的战略发展目标，具有良好的经济效益。公司在技术、人力、客户、管理等资源上有充分保障，通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会

2022年12月6日